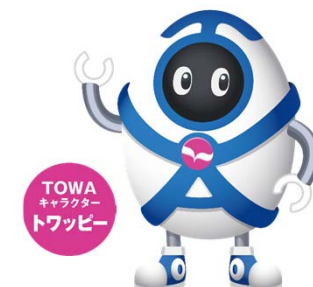




2025年3月期

第2四半期決算説明資料



2024年11月7日

TOWA株式会社

主な説明内容

1. 2025年3月期 上期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

主な説明内容

- 1. 2025年3月期 上期実績**
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期 上期サマリー

受注高
252.4億円

売上高
273.9億円

営業利益
52.6億円

経常利益
52.2億円

当期純利益
38.2億円

▶ 受注高

- ・ 中国での半導体内製化に向けた投資が好調。
- ・ 先端パッケージや通信デバイス関連向けにコンプレッション装置および金型の受注高は半期で過去最高。

▶ 売上高

- ・ 受注同様に中国、その他アジアが堅調。
- ・ 顧客稼働率改善により、TSS（トータル・ソリューション・サービス）売上が好調。

▶ 利益

- ・ 売上高の増加や製品ミックスの改善により、各段階利益ともに前年同期比で大幅増益。

2025年3月期上期決算のサマリーです。

受注高は中国での半導体内製化に向けた投資が堅調に推移しました。
また、当社独自のコンプレッション装置および金型の受注高は102.0億円となり、半期で過去最高となりました。

売上高は中国やその他アジア地域向けの売上高が堅調に推移したことや顧客の稼働率改善により、TSS（トータル・ソリューション・サービス）売上が好調に推移しました。

利益につきましては、売上高の増加や製品ミックスの改善により、各段階利益ともに前年同期比で大幅な増益となりました。

2025年3月期 上期連結業績結果

(単位：億円)

	2024/3期 上期実績	2025/3期 上期実績	前年比	2025/3期 上期予想	予想比
売上高	212.6	273.9	+ 61.3 (+ 28.8%)	287.0	▲ 13.0 (▲ 4.5%)
営業利益	23.8	52.6	+ 28.7 (2.2倍)	56.5	▲ 3.8 (▲ 6.9%)
営業利益率	11.2%	19.2%	+ 8.0pt	19.7%	▲ 0.5pt
経常利益	27.6	52.2	+ 24.6 (1.9倍)	56.5	▲ 4.2 (▲ 7.4%)
当期純利益	19.5	38.2	+ 18.6 (2.0倍)	39.6	▲ 1.3 (▲ 3.4%)

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

こちらは通期の業績結果です。

売上高は、中国やその他アジア地域向けが堅調に推移したことや、顧客の稼働率改善により、TSS（トータル・ソリューション・サービス）売上が好調に推移し、前年同期比28.8%増となりました。

利益につきましては、売上高の増加や製品ミックスの改善により、営業利益は前年比で約2.2倍、経常利益は約1.9倍、当期純利益は2.0倍と各段階利益ともに大幅な増益となりました。

詳細については、10ページの増減要因分析をご覧ください。

2025年3月期 上期セグメント別売上高

(単位：億円)

	2024/3期 上期実績	2025/3期 上期実績	前年比	2025/3期 上期予想	予想比
売上高	212.6	273.9	+ 61.3 (+ 28.8%)	287.0	▲ 13.0 (▲ 4.5%)
半導体事業	157.5	207.4	+ 49.9 (+ 31.7%)	213.0	▲ 5.5 (▲ 2.6%)
化成品事業	10.9	11.3	+ 0.3 (+ 3.1%)	11.0	+ 0.2 (+ 2.6%)
新事業	32.4	45.7	+ 13.3 (+ 41.1%)	50.0	▲ 4.3 (▲ 8.6%)
レーザ事業	11.8	9.5	▲ 2.2 (▲ 19.1%)	13.0	▲ 3.4 (▲ 26.6%)

こちらはセグメント別の売上高です。

半導体事業については、中国やその他アジア地域向けの売上が堅調に推移したことや、韓国地域での生成AI関連向け装置の納入が順調に進んだことから、前年同期比で31.7%増となりました。

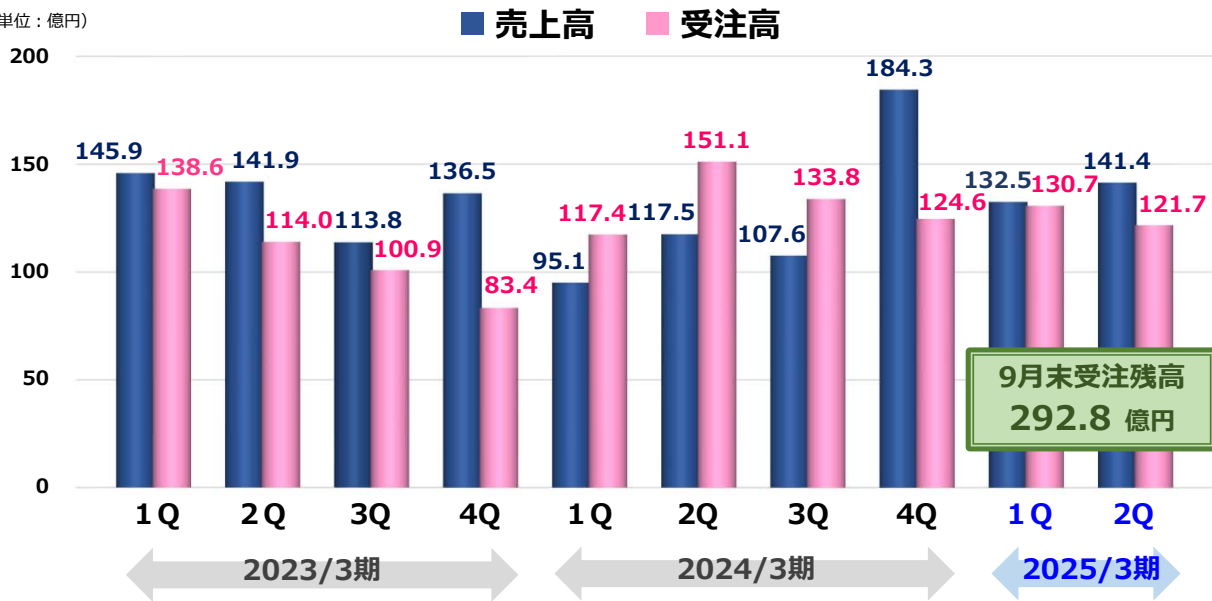
化成品事業については、医療用の成形品や組立品の需要が堅調であることや顧客の拡大が進んだことから、前年同期比で3.1%増となりました。

新事業については、顧客の稼働率改善によりTSS（トータル・ソリューション・サービス）の売上高が増加し、前年同期比41.1%増となりました。

レーザ事業については、自動車や産業機器向けなどのチップ抵抗器需要の回復が遅れていることから、前年同期比19.1%減となりました。

受注・売上高の推移

(単位：億円)

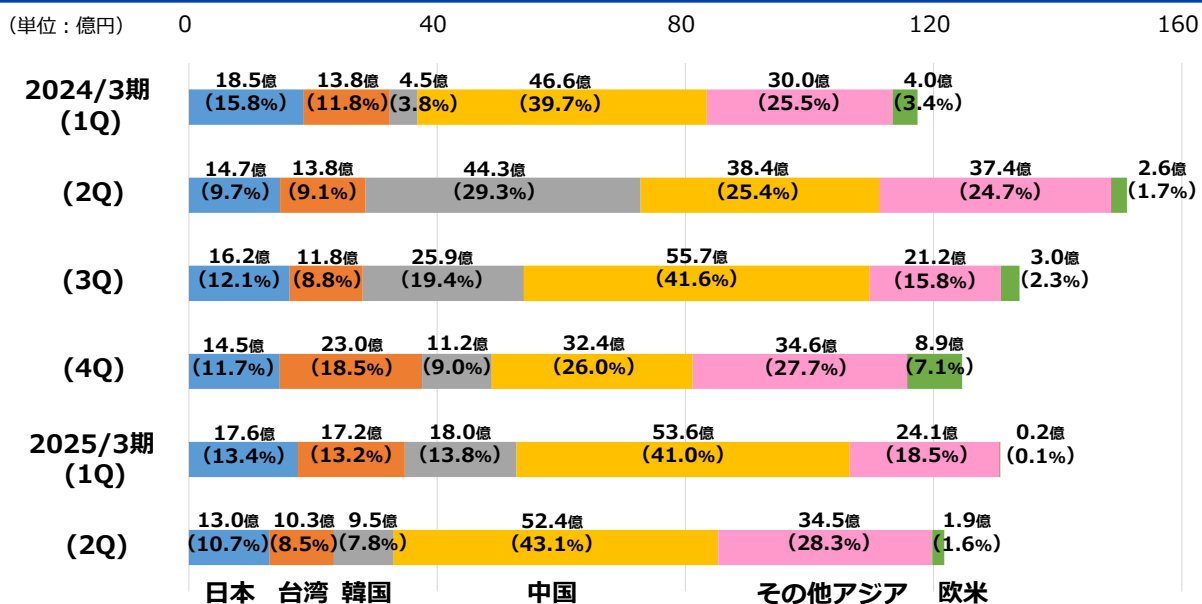


こちらは四半期ごとの受注・売上高の推移です。

売上高は受注残を着実に消化し、1Qは132.5億円、2Qは141.4億円と堅調に推移しました。

受注高につきましては、1Qは130.7億円に対して、2Qは121.7億円となりました。台湾OSATを中心に民生品向けの設備投資や、汎用メモリ向けの投資が遅れていることが主な要因です。

地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）



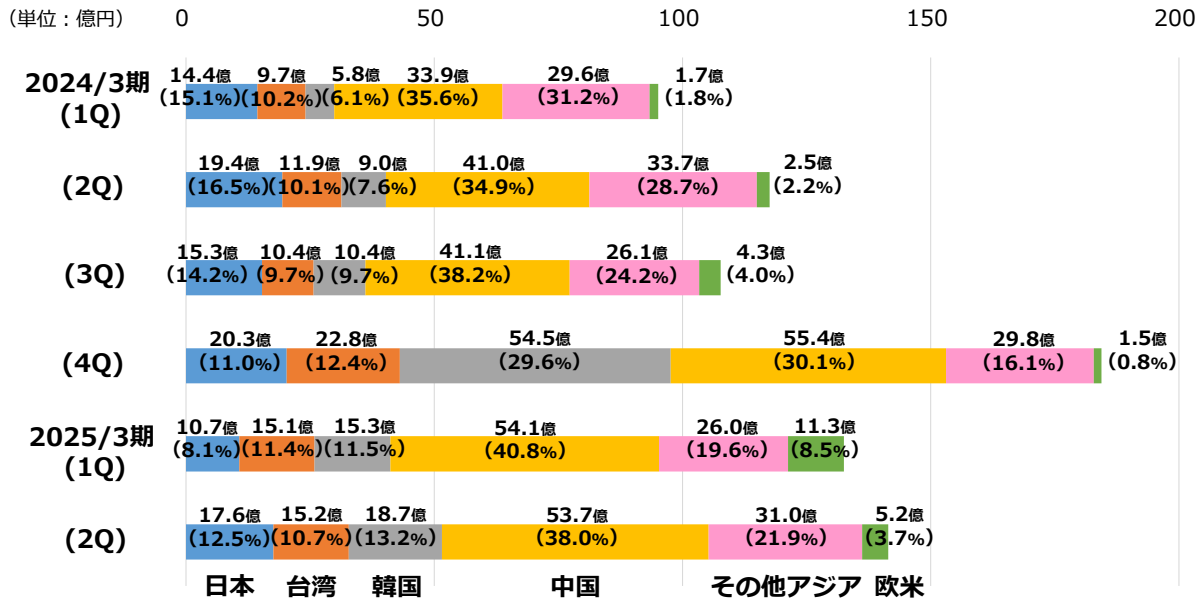
こちらは地域別の受注高です。金額は仕向地ベースとなっております。

中国地域においては半導体内製化に向けた投資により、高水準の受注が続いています。

一方、台湾地域では、顧客工場の稼働率改善に伴いTSSは増加しているものの、設備投資回復が遅れていることから低調に推移しています。

また、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）



こちらは地域別の売上高です。金額は受注同様、仕向地ベースとなっております。

中国地域は受注同様、半導体内製化に向けた投資により、高水準の売上高が継続しています。

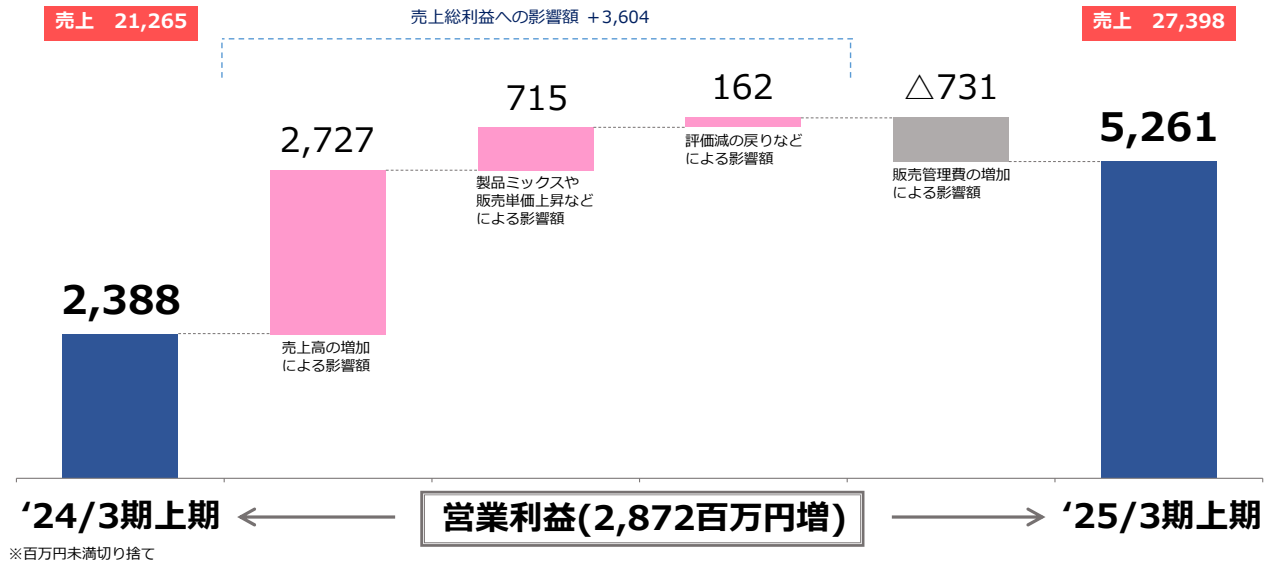
その他アジア地域は車載用半導体の投資が堅調で四半期で30億前後の売上高が継続しています。

韓国や台湾は生成AI関連の投資や顧客工場の稼働率改善に伴い、前年同期比では売上高が増加しました。

こちら、詳細なデータを決算補足資料として当社Webサイトに掲載しておりますので、あわせてご参照ください。

2025年3月期上期 連結営業利益 増減要因分析

(単位：百万円)



こちらは、前期上期と今期上期の営業利益の増減要因分析です。

参考としてご覧ください。

主な説明内容

1. 2025年3月期 上期実績
2. 2025年3月期 通期予想
3. TOPICS

2025年3月期 通期 連結業績予想

※期初予想から変更なし

(単位：億円)

	24/3期 通期実績	25/3期			増減額	前期比
		上期実績	下期予想	通期予想		
売上高	504.7	273.9	326.1	600.0	+ 95.2	+ 18.9%
営業利益	86.6	52.6	73.4	126.0	+ 39.3	+ 45.5%
営業利益率	17.2%	19.2%	22.5%	21.0%	-	+ 3.8pt
経常利益	90.7	52.2	73.8	126.0	+ 35.2	+ 38.8%
当期純利益	64.4	38.2	50.1	88.3	+ 23.8	+ 37.0%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

通期の業績予想についてです。

上期実績につきましては、予想をやや下振れしたものの、9月末時点の受注残高が292.8億円あり、3Q受注分の一部も4Qでの売上が見込まれることから、通期予想は期初予想を据え置いています。

今後の市場見通しの詳細につきましては、14ページをご覧ください

2025年3月期 セグメント別売上予想

※期初予想から変更あり

(単位：億円)

	24/3期 通期実績	25/3期			増減額	前期比
		上期実績	下期予想	通期予想		
売上高	504.7	273.9	326.1	600.0	+ 95.2	+ 18.9%
半導体事業	383.2	207.4	246.6	454.0	+ 70.8	+ 18.5%
化成品事業	21.5	11.3	11.0	22.3	+ 0.8	+ 3.7%
新事業	75.8	45.7	50.4	96.1	+ 20.3	+ 26.8%
レーザ事業	24.2	9.5	18.0	27.6	+ 3.4	+ 14.0%

こちらは、セグメント別の業績予想となります。

上期実績や受注残高、今後の見通し等を鑑みて、セグメント別の予想値を変更しております。

なお、合計の売上高に変更はございません。

今後の市場見通し

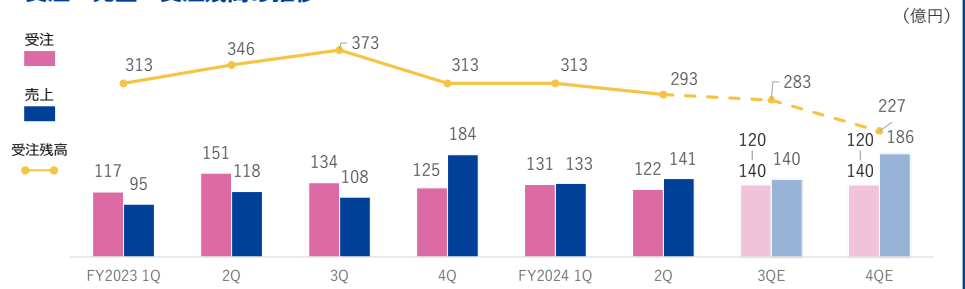
今後の市場見通し

- 受注高の見通しを修正。下期から見込んでいた民生品やメモリ関連の需要回復は後ろ倒しになっており、本格的な回復は来期以降を予想。
- 売上高については、2Q末時点の受注残高（293億円）及び下期の受注予定から通期予想は据え置き。なお、顧客納期の関係などから売上は4Qに集中する予定。
- 生成AI関連などの先端パッケージ向けは下期も堅調に推移する見込み。

損益予想 (変更なし)

売上高	600億円
営業利益	126億円
経常利益	126億円
当期利益	88.3億円

受注・売上・受注残高の推移



こちらは、今後の市場見通しについてです。

下期から見込んでいた民生品やメモリ関連の需要回復が後ろ倒しになっていることから、受注高の見通しを修正しました。本格的な回復は来期以降を予想しています。

売上高につきましては、2Q末時点の受注残高が約293億円あることや下期受注予定の一部も今期の売上高に含まれる予定であることから、通期予想を据え置いています。なお、顧客納期の関係などから売上は4Qに集中する予定です。

また、生成AI関連などの先端パッケージ向けについては、受注・売上ともに下期も堅調に推移する見込みです。

2025年3月期 配当計画

	2024/3期 実績	2025/3期 計画
配当	13.3円 (40.0円)	20.0円 (60.0円)

※当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
2024年3月期は株式分割されていたと仮定した金額を記載しています。
また、株式分割が行われる以前の金額を（ ）内で記載しています。
なお、中間配当は見送りとさせていただきます。

こちらは、今期の配当計画になります。

2024年5月に発表しました計画から変更はありません。

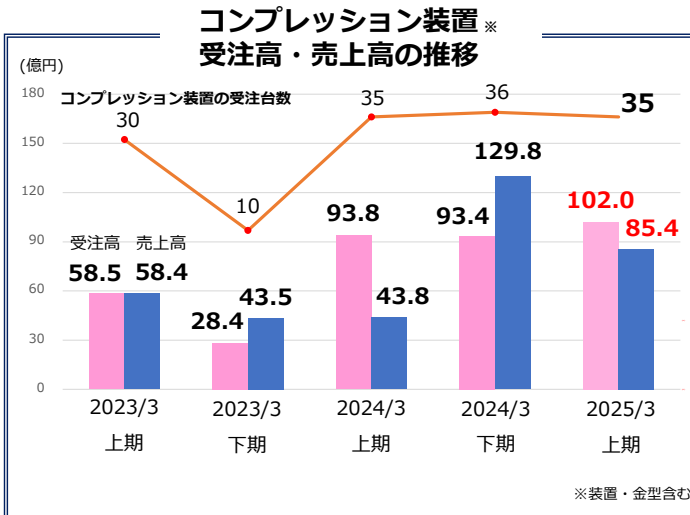
なお、当社は2024年10月1日付で1株から3株へ株式分割を行っております。
2024年3月期の配当については、株式分割されていたと仮定した金額を記載しております。

主な説明内容

1. 2025年3月期 上期実績
2. 2025年3月期 通期予想
- 3. TOPICS**

TOWA独自のコンプレッション装置

コンプレッション装置の受注・売上高は好調を維持！



独自のコンプレッション技術

- 薄型、積層、モジュール化されたパッケージに最適
- 独自技術により、狭ギャップ成形が可能
- 大判化されたパッケージにも対応可能

コンプレッション技術の活用が期待される分野

用途	技術
生成AI	ウェハーレベルパッケージ
次世代スマホ	パネルレベルパッケージ
自動運転	2.5D、3Dパッケージ
IoT	

ここからは今回のトピックスになります。
最初はTOWA独自のコンプレッション装置についてです。

コンプレッション装置の受注・売上高は先端パッケージや通信デバイス関連向けに前期上期から好調を維持しており、今期上期の受注高は102.0億円と半期で過去最高となりました。

TOWA独自のコンプレッション技術は樹脂流動がないため、チップやワイヤへのダメージがなく、薄型、積層、モジュール化されたパッケージに最適な技術です。

また、基板を樹脂に漬け込む独自の方式により、狭ギャップへの樹脂充填も可能な技術となっています。

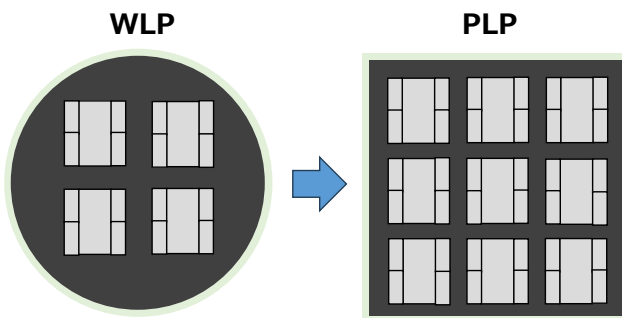
コンプレッション技術の活用が期待される分野における、用途・技術には記載のようなものがあります。

PLP（パネルレベルパッケージ）については次のスライドにてご説明します。

PLP (Panel Level Package)

PLP向け装置の引合・受注が増加

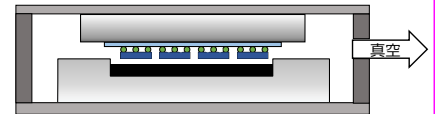
- 生産効率向上を目的に、WLPからPLPへ製造プロセスが移行
⇒ **コンプレッション装置の優位性はより高まる！**



**1回で成形できる製品数が増加し、
生産効率が大幅に改善！**

PLPに対するコンプレッション装置の優位性

**TOWA独自のキャビティダウン構造により、
パネルの四隅にまで樹脂を隙間なく
充填！**



PLP向けコンプレッション装置
Model: CPM1180
Work max size : 660x620mm

PLP (パネルレベルパッケージ) についてです。

PLP向けコンプレッション装置の引合・受注が増加しています。
こちらの図のようにPLPはWLPに比べて1回で成形できる製品数が増加し、半導体の生産効率を大幅に改善することが可能です。そのため、WLPからPLPへの移行が見込まれます。

TOWA独自のキャビティダウン方式では、パネルの四隅にまで樹脂を隙間なく充填することができるため、よりコンプレッション装置の優位性は高まります。

TOWAのPLP向けコンプレッション装置は大判パネル最大660mm×620mmの自動成形が可能となっています。

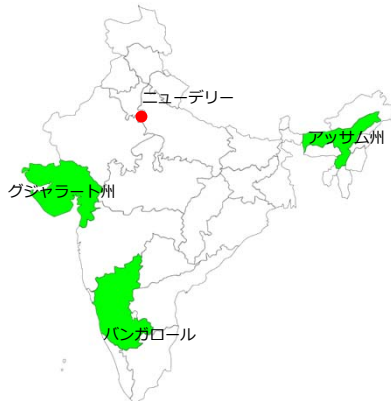
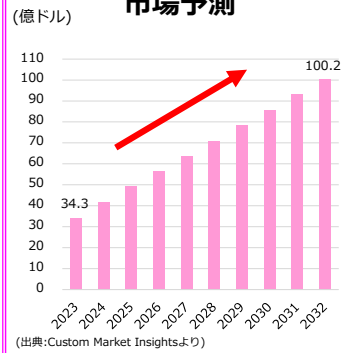
インドでのビジネス強化

インドにおける事業強化に向け、販売子会社設立を決定

▶ インドでは政府支援のもと半導体産業育成に注力しており、すでに地場の大手財閥や大手半導体メーカーが投資計画を決定。

⇒ 直接現地で営業活動を展開し、立上げ期よりお客様と強固な関係を築く。

インド半導体市場予測



会社概要

社名	TOWA India Company Limited. (仮)
所在地	インド共和国 ハリヤナ州 グルガオン (予定)
事業内容	半導体製造装置・金型の販売およびアフターサービス
資本金	25,000千インドルピー (約42,750千円)
設立時期	2025年3月までを目途に設立予定

インドでのビジネス強化についてです。

インドにおける事業強化に向け、販売子会社の設立を決定しました。

インドでは政府支援のもと半導体産業育成に注力しており、すでに地場の大手財閥や大手半導体メーカーが投資計画を決定しております。今後も中長期的に半導体市場の成長が期待されています。

当社は、現地で直接営業活動やサービス活動を行うことにより、市場の立上げ期からお客様と強固な関係を築いていきます。

その他トピックス

株式分割を実施

2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しました。

投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。



「JPX日経インデックス400」構成銘柄選定

JPX総研及び日本経済新聞社が共同で算出する「JPX日経インデックス400」の2024年度（2024年8月30日～2025年8月28日）の構成銘柄として選定されました。構成銘柄の選定は、時価総額によるスクリーニングに加え、3年平均ROEなどの定量的な指標による評価、独立社外取締役の選任などの定性的な指標による評価をもとにおこなわれ、400銘柄が選定されています。



JPX-NIKKEI 400

「TOWA統合報告書 2024」発行（日・英）

当社は、財務・非財務情報を統合的に発信するために、マテリアリティの情報も盛り込んだ統合報告書「TOWA統合報告書 2024」を発行いたしました。当社HP上で公開していますので、ぜひご覧ください。

<ご参考> 【TOWA統合報告書 2024】
<https://www.towajapan.co.jp/jp/ir/corporatereport/>

「えるぼし」認定

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業として、厚生労働省より「えるぼし」認定を受けました。当社は今後も両立支援を推進し、女性を含むすべての従業員が能力を最大限発揮し、笑顔で働くことのできる職場づくりに継続して取り組んでまいります。



こちらはその他トピックスについてです。

TOWAは2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しました。投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を目的としています。

また、JPX総研及び日本経済新聞社が共同で算出する「JPX日経インデックス400」の2024年度（2024年8月30日～2025年8月28日）の構成銘柄として選定されました。

今年度も「TOWA統合報告書 2024」を発行し、HP上で公開しております。ぜひご覧ください。

女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業として、厚生労働省より「えるぼし」認定を受けました。今後も両立支援を推進し、女性を含むすべての従業員が能力を最大限発揮し、笑顔で働くことのできる職場づくりに継続して取り組んでまいります。

T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。

参考資料



会社概要

会社名	TOWA株式会社
事業内容	半導体・LED製造装置、超精密金型、 ファインプラスチック成形品、レーザー加工装置
設立	1979年4月
代表者	代表取締役社長 岡田 博和
従業員数	2,056名(連結) [2024年9月末]
資本金	89億円
証券コード	6315
所在地	京都市南区上烏羽上調子町5番地

事業内容

新事業

- ・TSS (トータルソリューションサービス)
- ・精密加工用工具、受託加工
- ・微細加工
- ・コーティング



化成品事業

- ・ファインプラスチック成形品
- ・医療機器



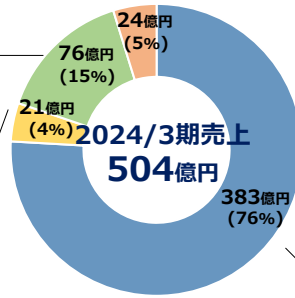
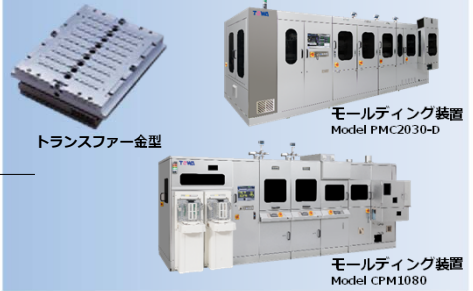
レーザー加工装置事業

- ・レーザトリマ
- ・ウェハーマーカ
- ・レーザ溶接機



半導体事業

- ・半導体製造用精密金型
- ・半導体製造用モールドイング装置
- ・半導体製造用シングュレーション装置



生産拠点

● TOWA ● グループ会社

韓国

- TOWA韓国株式会社
- TOWAファイン株式会社

半導体製造装置、精密金型、部品の製造

ブレードの製造



中国

- TOWA半導体設備（蘇州）有限公司

半導体製造装置、精密金型の製造



- 東和半導体設備（南通）有限公司

半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

- TOWAM Sdn. Bhd.
- TOWA TOOL Sdn. Bhd.

半導体製造装置の製造

半導体製造用金型の製造



京都

- 本社・工場（京都市）

半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

- 京都東事業所（宇治田原町）

半導体製造用金型の製造



佐賀県（鳥栖市）

- 九州事業所

半導体製造用金型の製造



山梨県（韮崎市）

- 株式会社バンディック

ファイナプラスチック成形品の製造



神奈川県（相模原市）

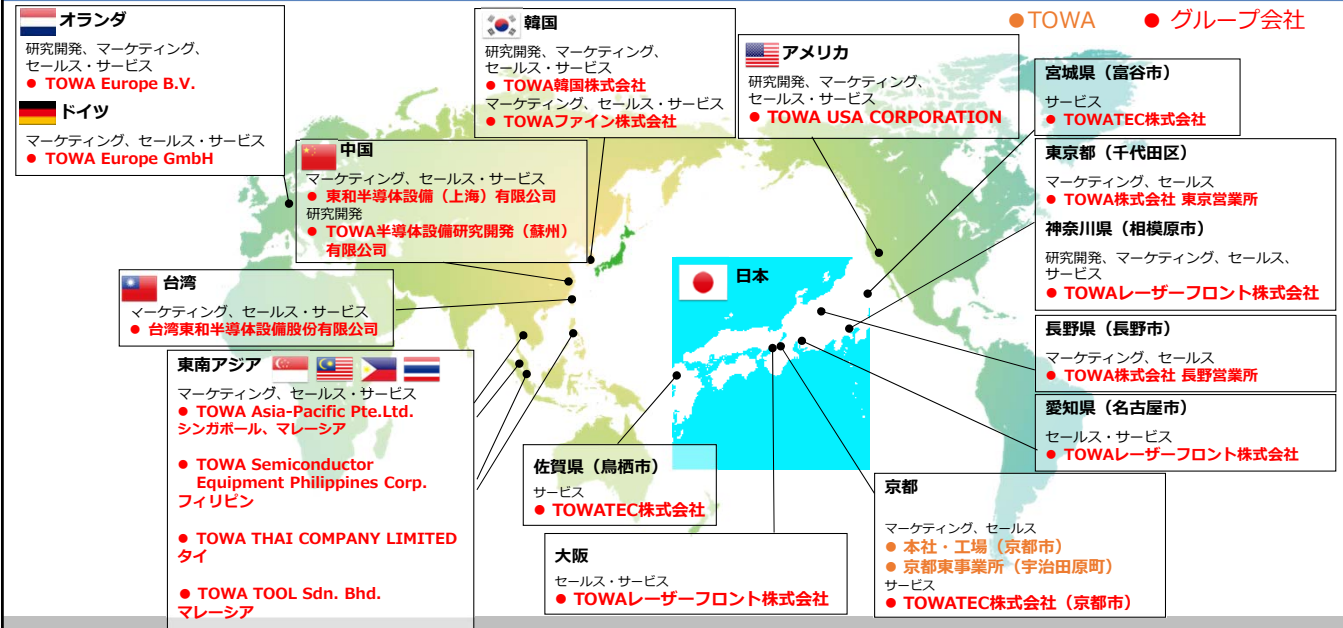
- TOWAレーザーフロント

株式会社

レーザー及びレーザー加工装置の開発、製造

販売・サービス拠点

● TOWA ● グループ会社

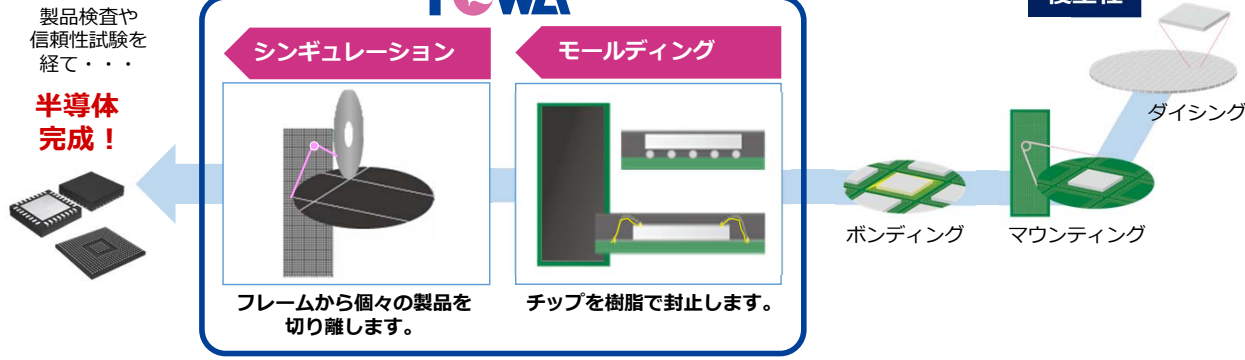


半導体が出来るまで

前工程

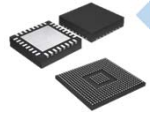


後工程



製品検査や信頼性試験を経て・・・

半導体完成!



TOWA

シングュレーション

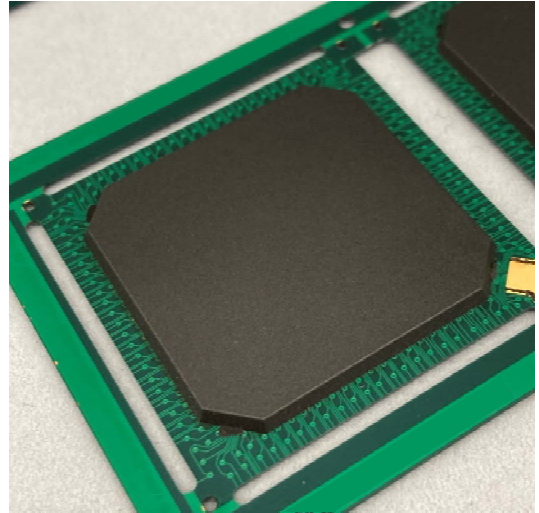
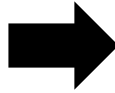
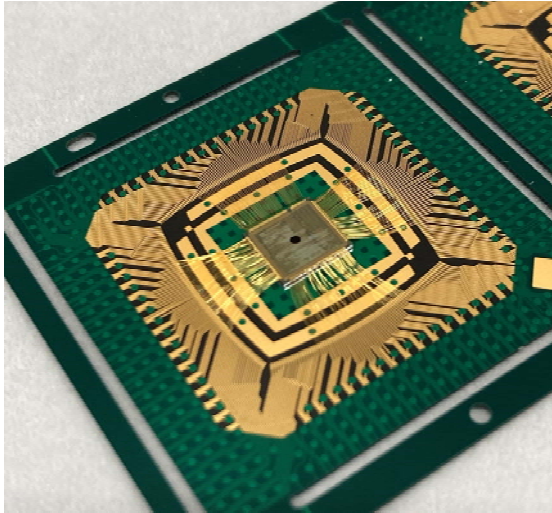
フレームから個々の製品を切り離します。

モールドイング

チップを樹脂で封止します。

半導体樹脂封止（モールドイング）

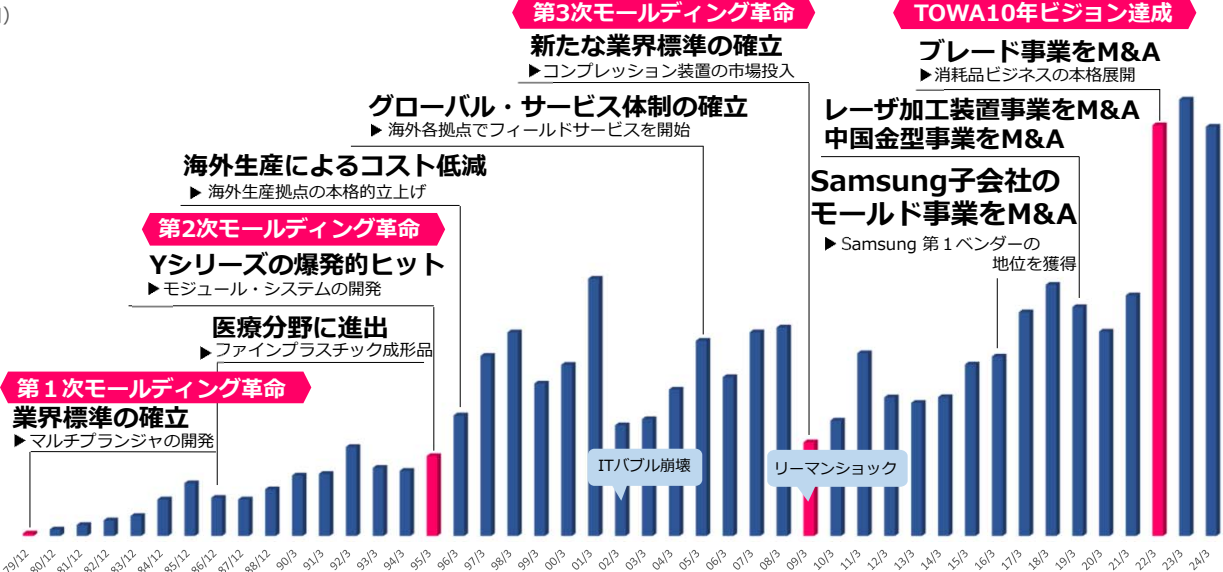
半導体チップやワイヤーを樹脂で包み保護する



TOWAの歩み

(億円)

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

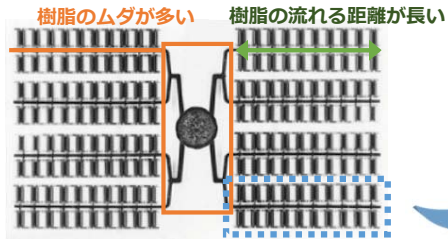


1979年4月 創業 ※ 89/3は決算期変更にともなう3ヵ月決算 1996年9月 大証2部上場 2000年11月 東証1部上場 2022年3月 TOWAビジョン2032発表

第1次モールドイング革命(1979年)

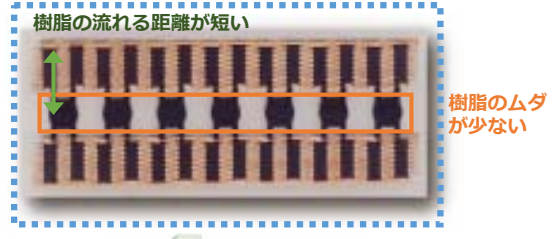
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く成形品質にバラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く成形品質が向上し**、**樹脂のムダが少ない**。



第2次モールドイング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドイング装置は・・・

- ・一品一様であり、生産する製品毎に装置を買い替え
- ・生産量に応じて複数の装置を保有する必要がある



モジュールシステムによりプレスが増減が可能に!!

- ・Yシリーズだけで様々な製品の生産が可能
- ・生産量に応じて追加で設備投資が可能

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールドイング装置のベストセラー



第3次モールドディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

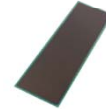
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで他社の追随なし。

特 徴

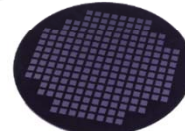
- ・樹脂使用効率**100%**（CO2排出量約**70%**削減）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（不良品が少ない）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



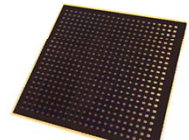
コンプレッション装置
Model PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
φ300mm



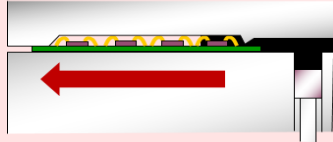
パネルサイズ
600mm×600mm

半導体パッケージへのソリューション

トランスファー成形

注入方式

樹脂流動有

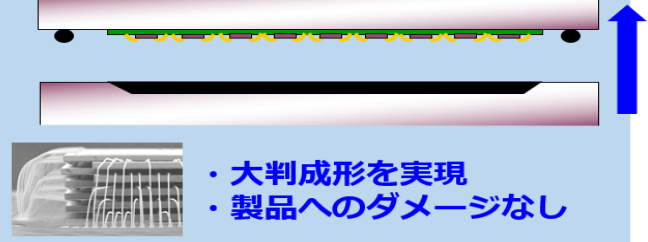
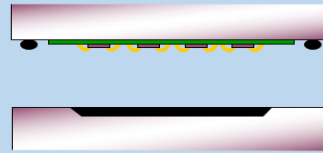


- ・未充填
- ・ワイヤダメージ発生

コンプレッション成形

圧縮方式

樹脂流動無



- ・大判成形を実現
- ・製品へのダメージなし

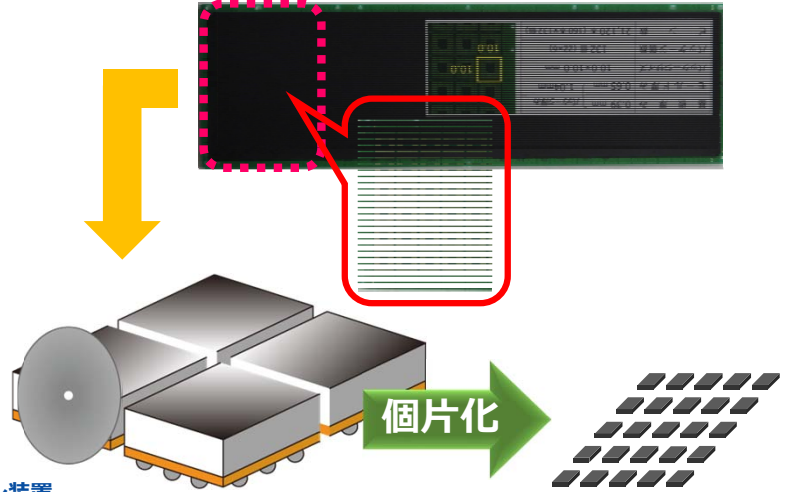
シンギュレーションプロセス

モールドイング後、1つ1つの半導体に個片化する

業界最小！
1.0×1.0mmの
個片化が可能



シンギュレーション装置
Model FMS 4040



半導体製造装置ラインナップ

～ Compression Mold ～

コンプレッション装置
Model CPM 1180



Work max size: 660x620mm

コンプレッション装置
Model CPM 1080



Work max size: ϕ 300mm, 320x320mm

コンプレッション装置
Model PMC 2030-D



Work max size: 100x300mm

～ Transfer Mold ～

トランスファ装置
Model YPM 1180



Work max size: 100x300mm

～ Singulation ～

シンギュレーション装置
Model FMS 4040



Work max size: 100x300mm